
2025年12月期 第3四半期 決算説明会

2025年11月11日（火）

 **メック株式会社**

証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

1

売上： 14,987百万円（前年同期比 9.5%増加）
営業利益： 4,247百万円（前年同期比 16.4%増加）

2

為替の影響は前年同期比

売上：23百万円減少、営業利益：11百万円減少

3

薬品売上： 14,559百万円（前年同期比 11.6%増加）
出荷量： 34,844ton （前年同期比 10.9%増加）

4

主要製品売上は前年同期比

CZ 16.4%増加、V-Bond 1.3%減少、EXE 1.6%減少、SF 35.7%減少

(単位：円)

	期初想定	2025 3Q	2024 3Q	2025 1H
N T D	4.76	4.75	4.72	4.68
R M B	21.08	20.60	20.95	20.53
H K D	19.48	19.08	19.28	19.11
T H B	4.22	4.48	4.24	4.44
E U R	164.84	165.47	163.86	162.60
U S D	152.33	148.79	150.62	148.98

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける
- いずれも、期中平均レートを採用
- 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）および中国人民元（RMB）
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり
 NTD：（売上）59百万円（営業利益） 40百万円
 RMB：（売上）23百万円（営業利益） 11百万円
 ＊いずれも、当期3Q実績累計期間

* 2025年12月期 通期業績予想の修正において、為替レートは期初想定から変更はありません。

2025年12月期 第3四半期 業績概要



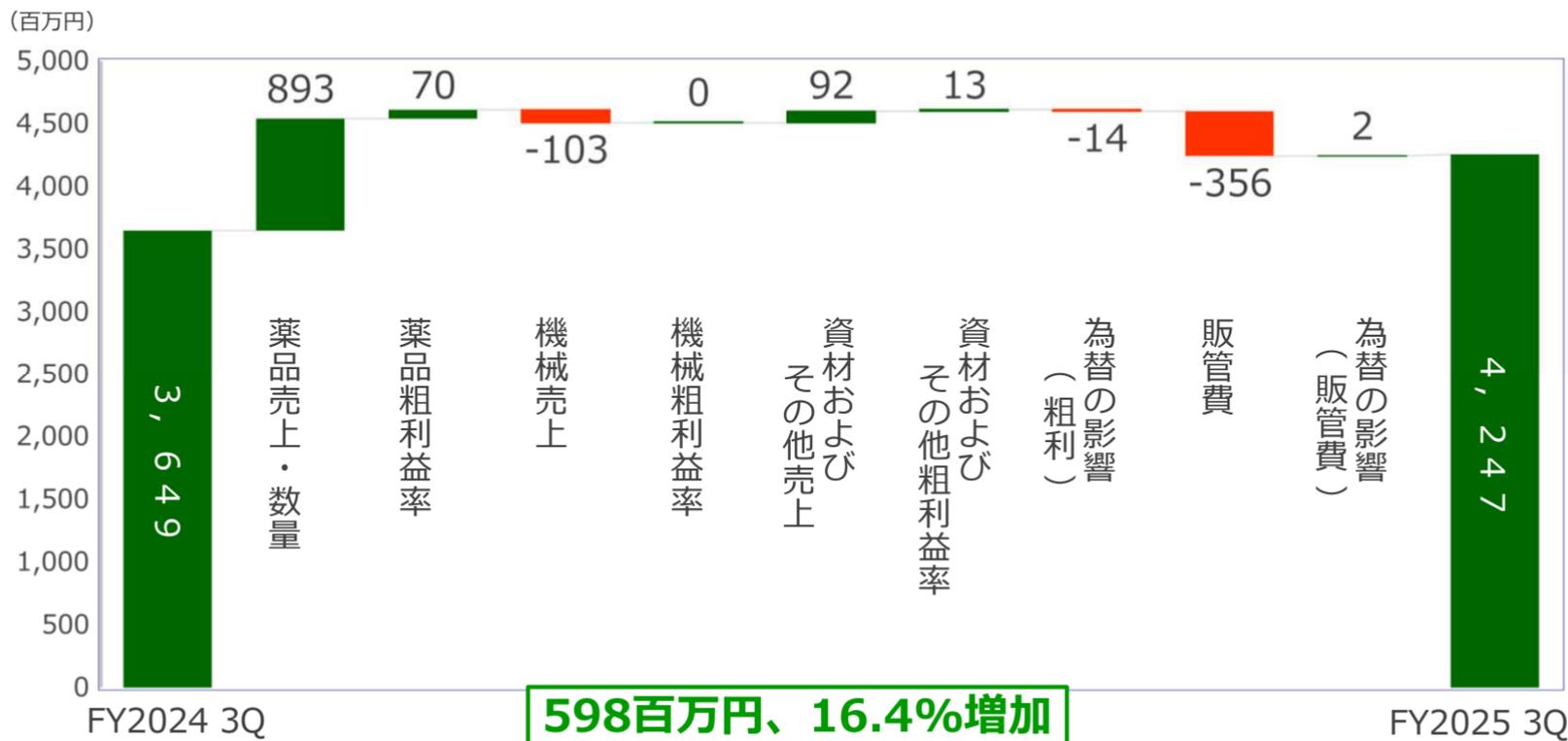
(単位：百万円)

	第3四半期						通期		
	FY24.12		FY25.12				FY24.12	FY25.12	
	(実績)	進捗率	(実績)	進捗率	前年同期比	(実績)	(予想)	前期比	
売上高	13,682	75.0%	14,987	73.8%	1,305	9.5%	18,234	20,300	11.3%
薬品売上高	13,041	-	14,559	-	1,517	11.6%	17,478	-	-
売上総利益	8,397	-	9,349	-	952	11.3%	11,101	-	-
売上総利益率	61.4%	-	62.4%	-	-	-	60.9%	-	-
販売費及び一般管理費	4,747	-	5,101	-	354	7.5%	6,539	-	-
売上高比率	34.7%	-	34.0%	-	-	-	35.9%	-	-
営業利益	3,649	80.0%	4,247	77.2%	598	16.4%	4,562	5,500	20.5%
営業利益率	26.7%	-	28.3%	-	-	-	25.0%	-	-
経常利益	3,700	79.0%	4,361	77.2%	661	17.9%	4,682	5,650	20.7%
経常利益率	27.0%	-	29.1%	-	-	-	25.7%	-	-
税引前当期利益	3,695	-	4,761	-	1,066	28.9%	4,669	-	-
当期純利益	2,627	114.7%	3,329	77.4%	701	26.7%	2,291	4,300	87.6%
EBITDA	4,296	-	5,364	-	1,068	24.9%	5,487	-	-
1株当たり当期利益 (円)	140.32	-	179.53	-	-	-	122.38	232.71	-
1株当たり配当金 (円)	-	-	-	-	-	-	45.00	85.00	-
ROE	10.3%	-	12.1%	-	-	-	8.9%	15.3%	-

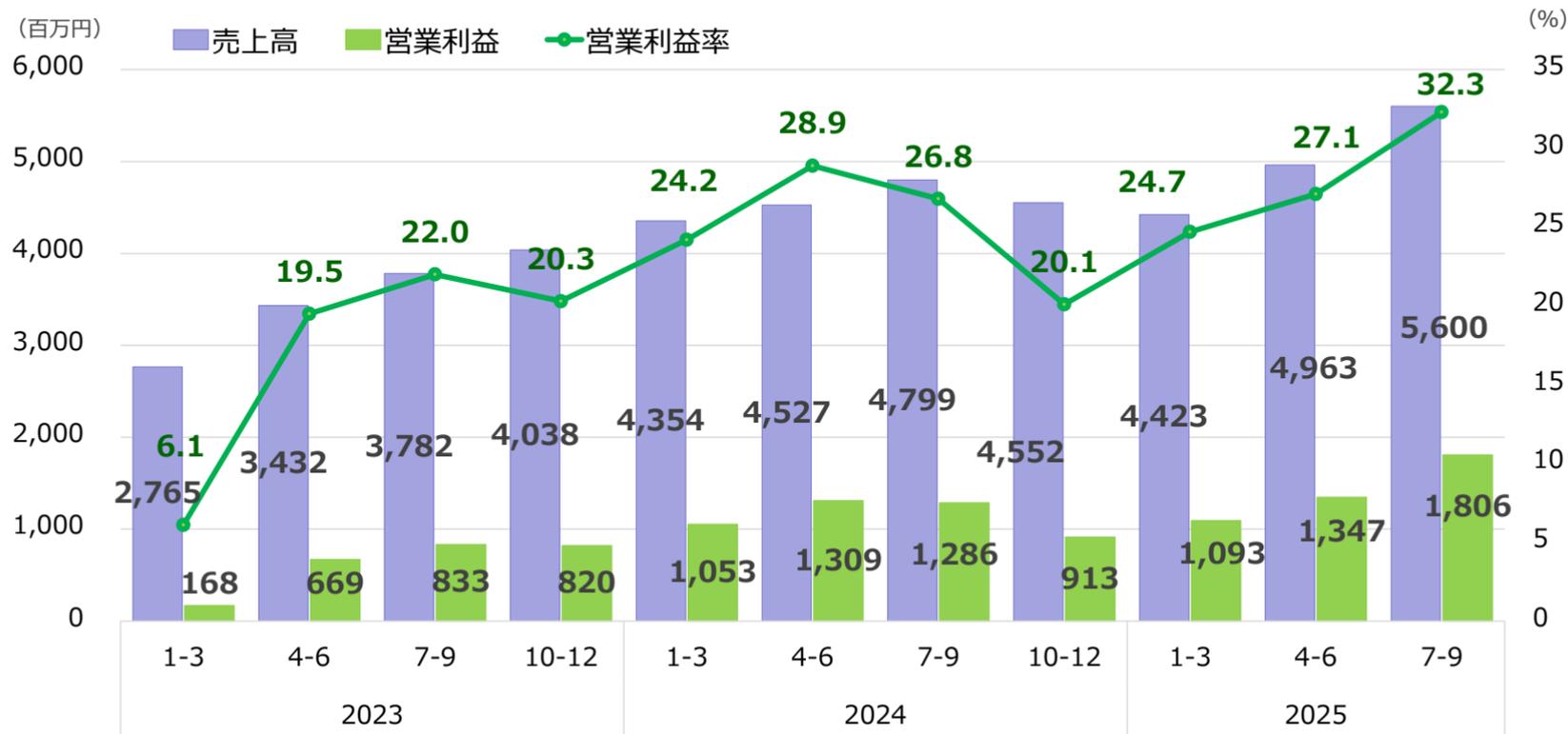
連結売上高前年同期比分析



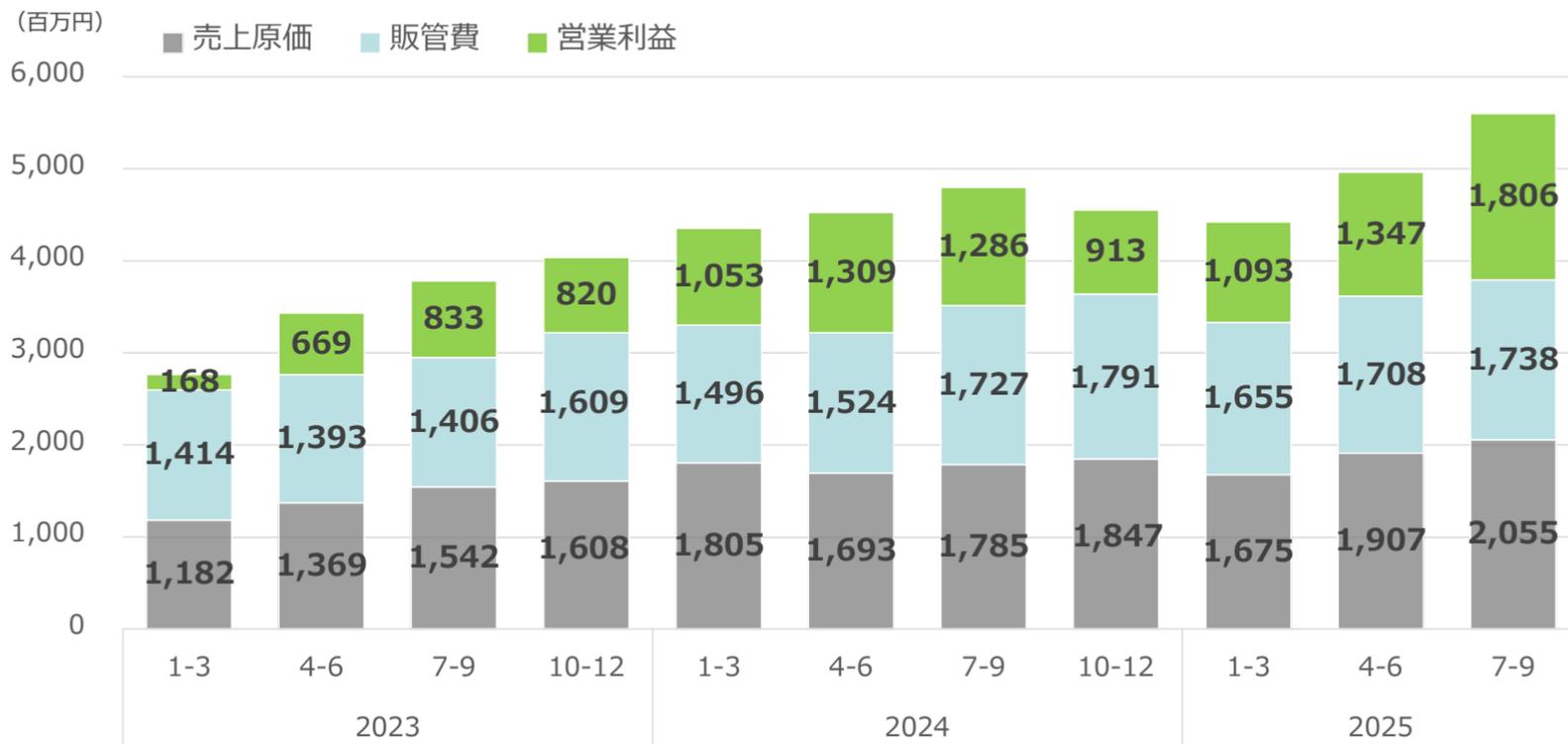
連結営業利益前年同期比分析



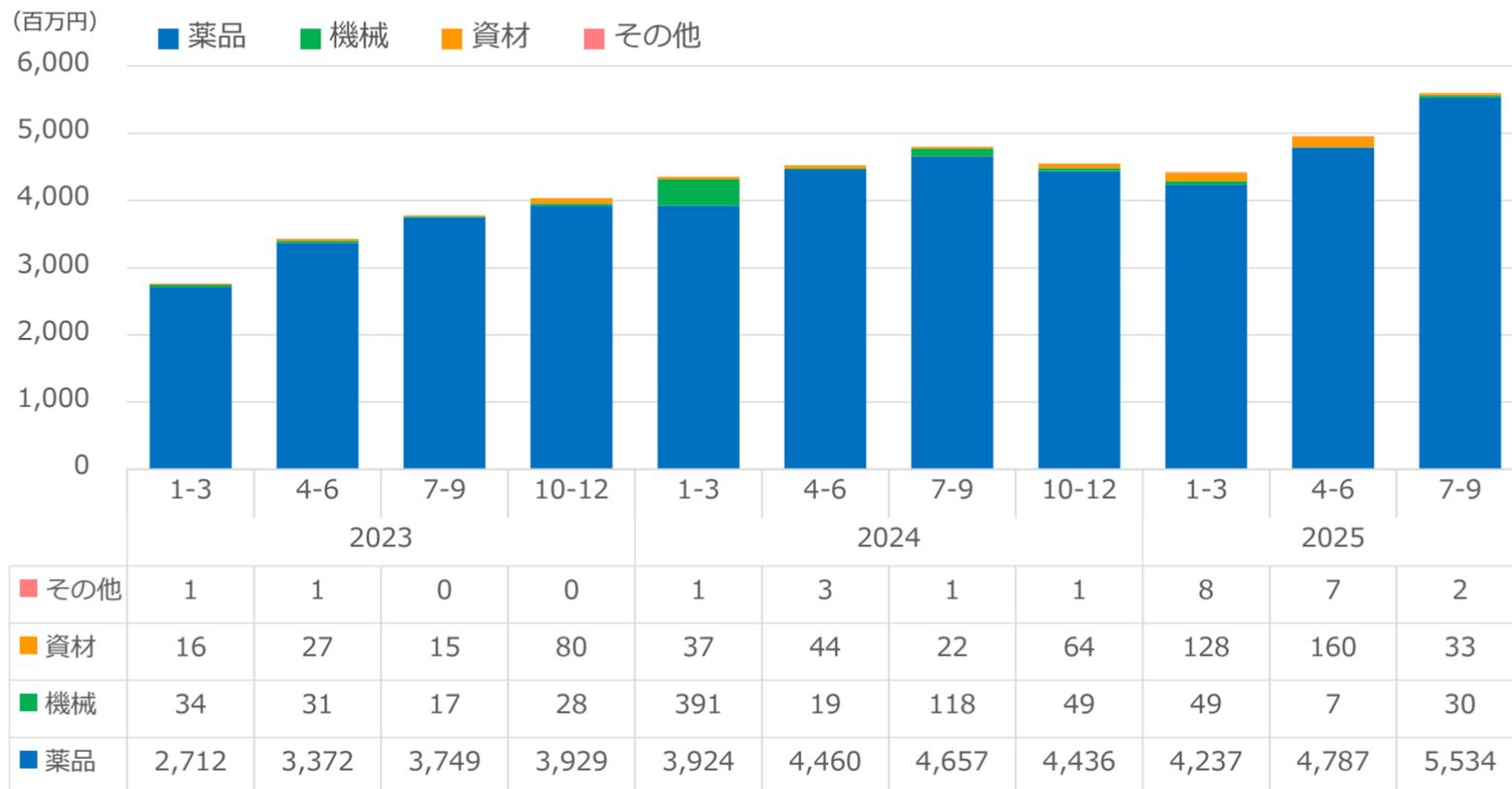
連結売上高と営業利益/営業利益率



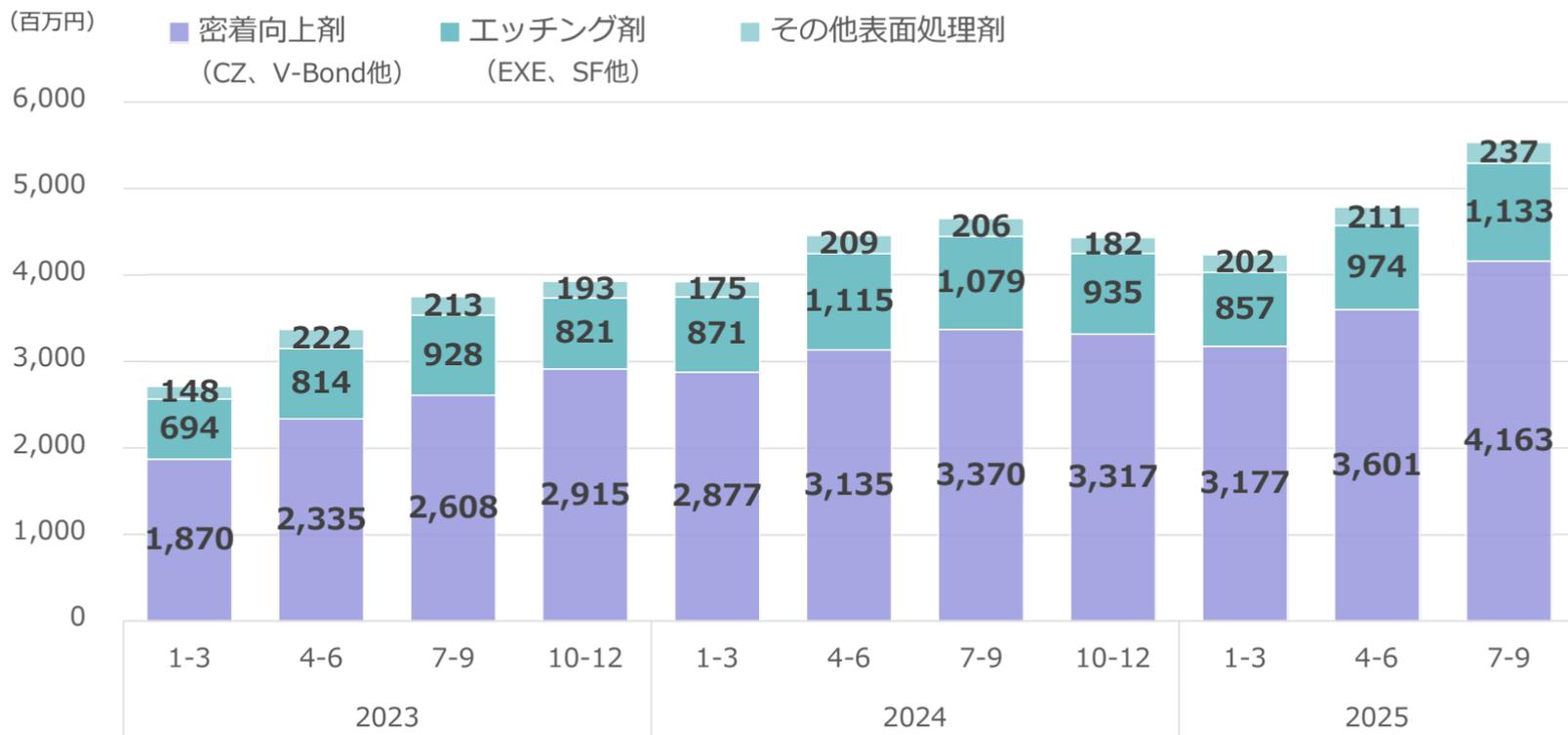
連結損益構造



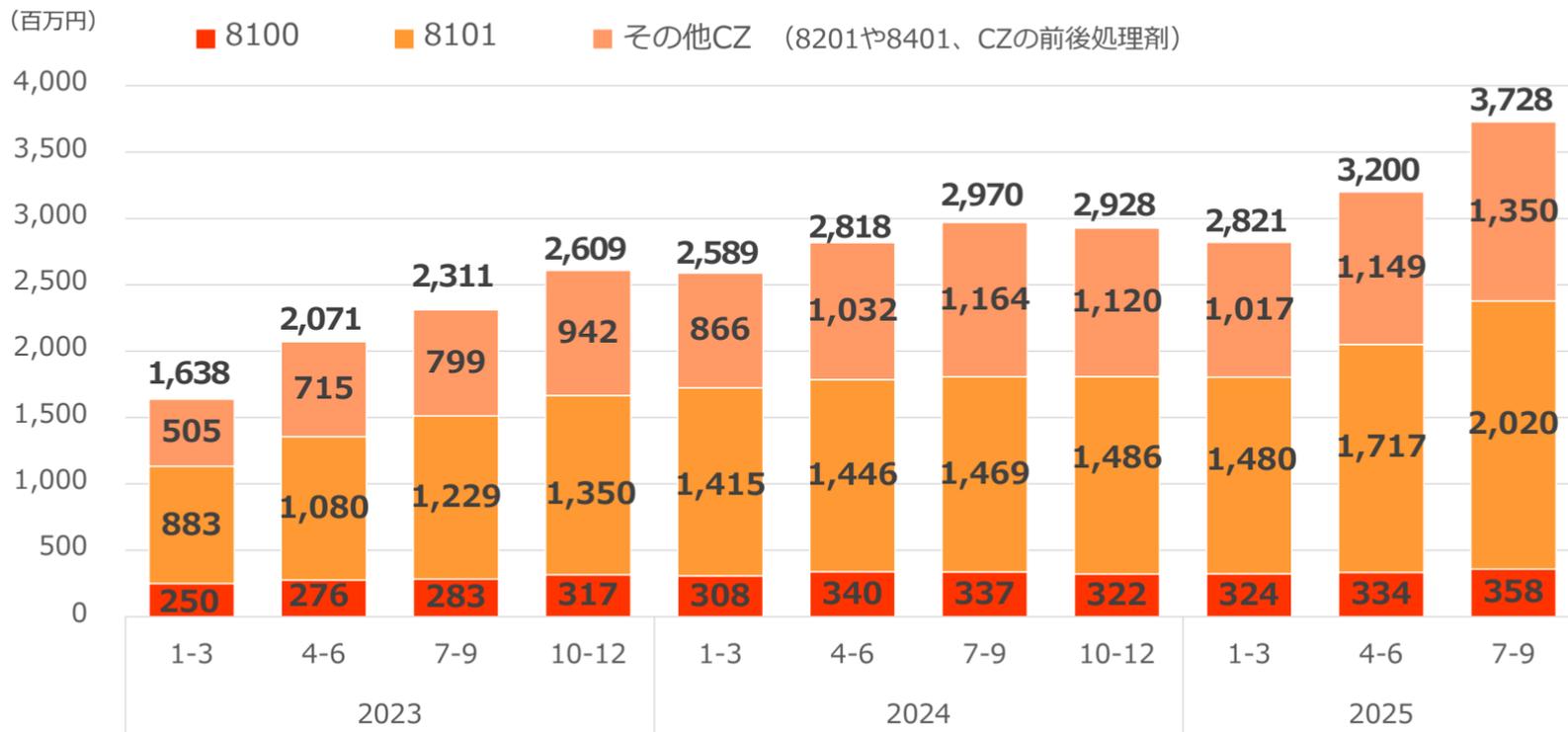
連結品種別売上高



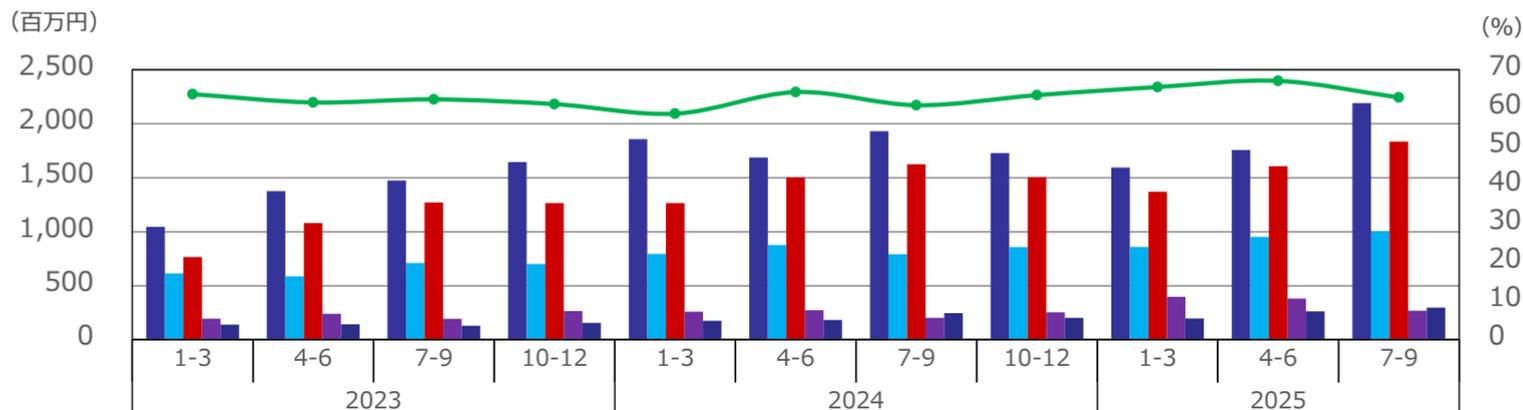
連結薬品別売上高



CZシリーズ売上高



地域セグメント別売上高



■ 日本	1,046	1,376	1,474	1,645	1,857	1,688	1,931	1,728	1,594	1,756	2,191
■ 台湾	615	589	711	703	795	878	792	859	860	954	1,006
■ 中国	767	1,081	1,272	1,266	1,265	1,504	1,625	1,506	1,370	1,607	1,835
■ 欧州	195	240	193	266	259	273	202	254	400	382	269
■ タイ	140	143	129	156	176	183	246	203	197	262	297
● 海外売上高比率	63.7	61.5	62.3	61.1	58.6	64.2	60.8	63.4	65.5	67.1	62.8

・日本国内代理店経由で販売した海外顧客への売上を海外売上高比率に含めた場合の比率は、80.6%（前年同一期間は、77.8%）。

今後の見通し

④ 事業環境

- ・短期的には、回復基調にある半導体市況の影響を見込む。
- ・中長期的には、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進む。
これら技術の広がりを背景に、当社関連市場の拡大を見込む。
- ・特に高まる半導体需要による半導体PKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により、関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

④ 主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況の影響を受ける。
中長期的には半導体PKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大を見込む。
- V-Bond : 短期的にはクルマ、スマートフォンは回復基調。衛星通信基板向け増加基調。
- EXE : ディスプレイ需要の影響を受ける。
- SF : タブレットPC需要の影響を受ける。

2025年12月期 連結業績予想

	FY2024		FY2025 (2025/11/11修正)		
	百万円	利益率(%)	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	18,234	-	20,300	-	11.3%
営業利益	4,562	25.0	5,500	27.1	20.5%
経常利益	4,682	25.7	5,650	27.8	20.7%
純利益	2,291	12.6	4,300	21.2	87.6%
1株当たり純利益(円)	122.38	-	232.71	-	-



為替レート

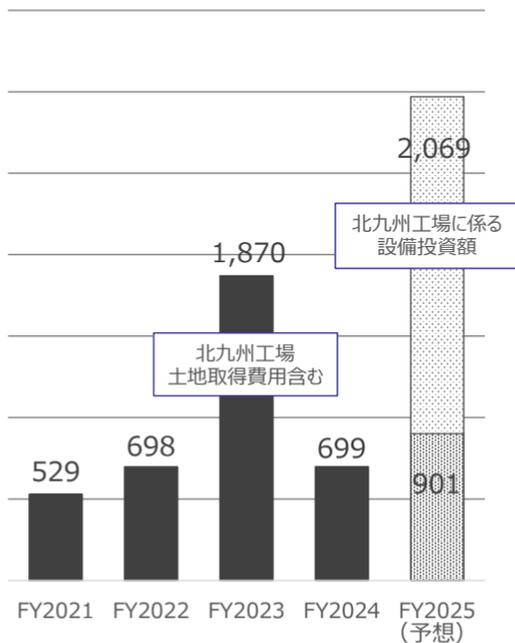
	FY2024 (実績)	FY2025 (想定)
N T D	4.72	4.76
R M B	21.04	21.08
H K D	19.41	19.48
T H B	4.31	4.22
E U R	163.79	164.84
U S D	151.44	152.33

* 2025年12月期 通期業績予想の修正において、為替レートは期初の想定から変更ありません。

設備投資額と減価償却費、研究開発費

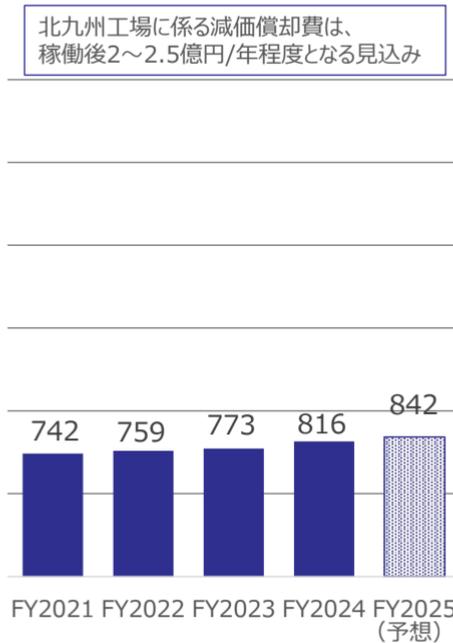
設備投資額

(百万円)



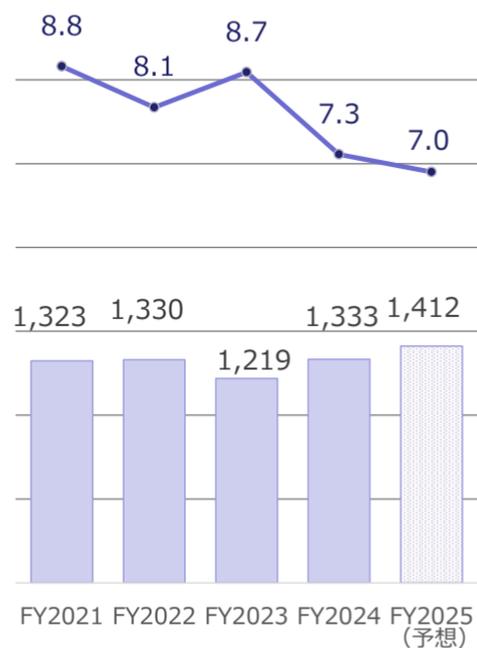
減価償却費

(百万円)



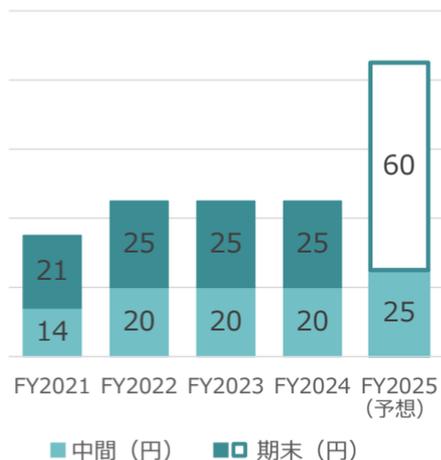
研究開発費と 売上高研究開発費比率

(百万円,%)

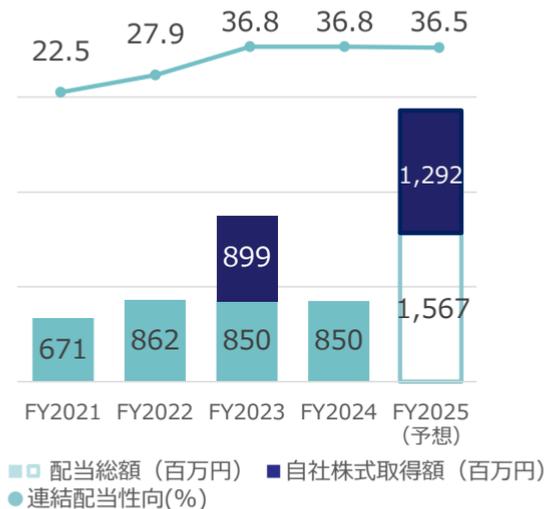


配当金と連結配当性向、ROEの推移

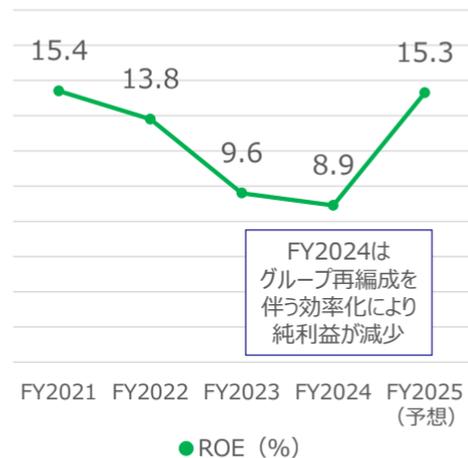
1株当たり配当金



配当総額/自己株式取得額/連結配当性向



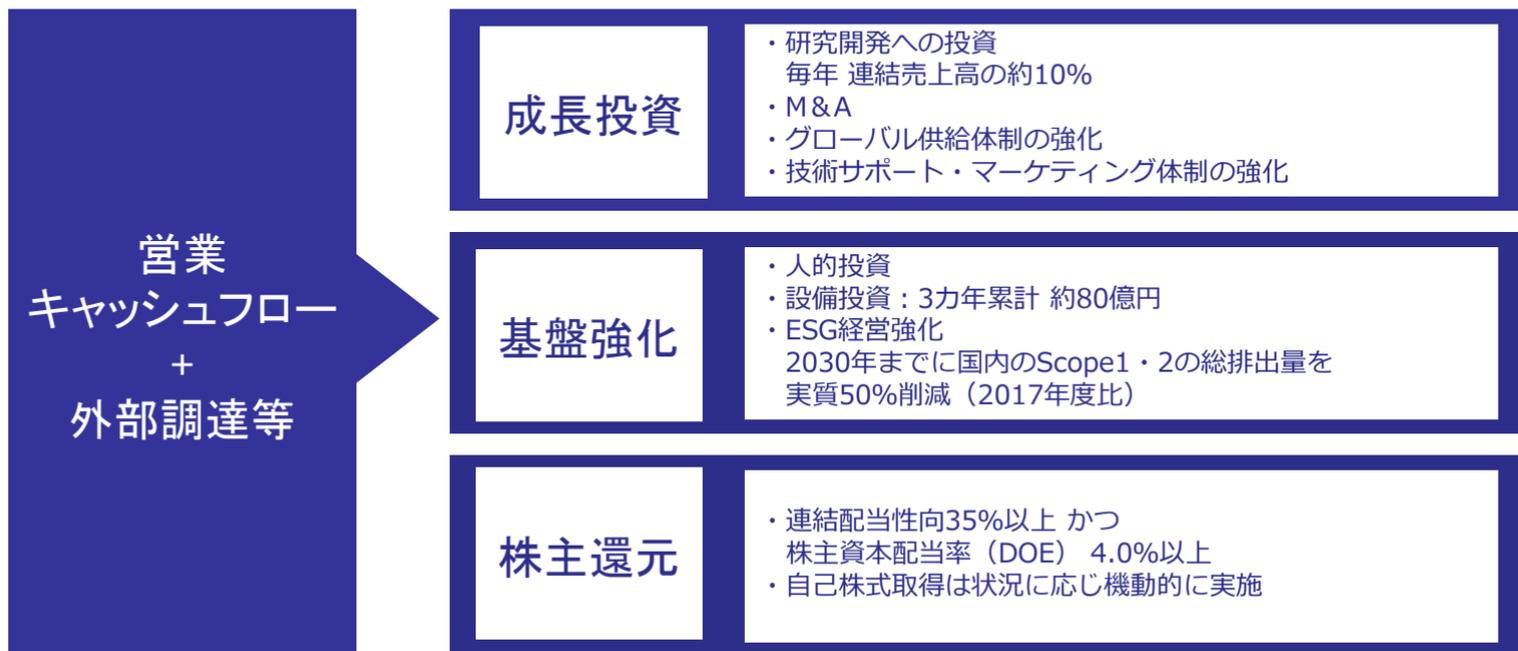
ROE



【株主還元方針】 ・連結配当性向35%以上かつDOE 4.0%以上
 ・自己株式取得は状況に応じ機動的に実施

【ROE目標】 10%以上

経営資本を投入し事業活動により得た利益は、バランスを見ながら株主還元や成長投資、基盤強化に配分します



Environment

- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 気候関連問題への対応

Social

- 人的資本戦略
- 多様な人材の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

Governance

- 経営基盤の強化（CG体制、リスクマネジメント、コンプライアンスの徹底等）

超高密度
超高周波



最先端品 化学密着向上剤APシリーズ



Flat Organic Adhesion Promotor

先端品 CZ-8401
×化学密着向上剤APシリーズ
CZ-8201



Super finely roughen + Organic Adhesion Promotor

汎用品 CZ-8101
CZ-8100



Very finely roughened

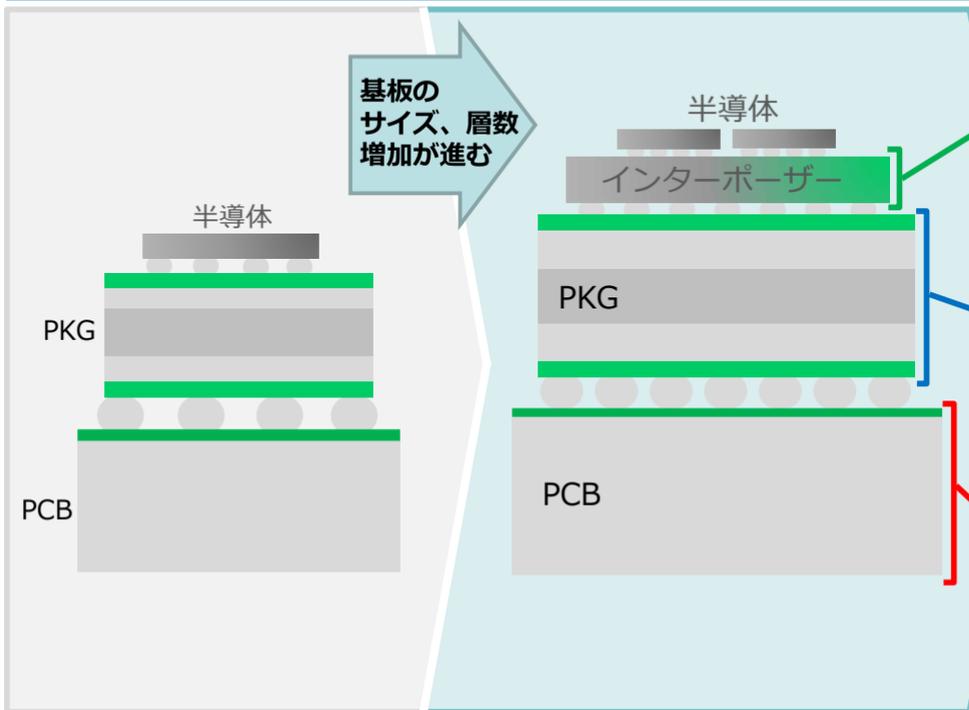


Finely roughened

技術領域の拡大を目指して

当社技術の進化と求められる技術

超高密度化、信号低損失、低消費電力



新領域（インターポージャー）

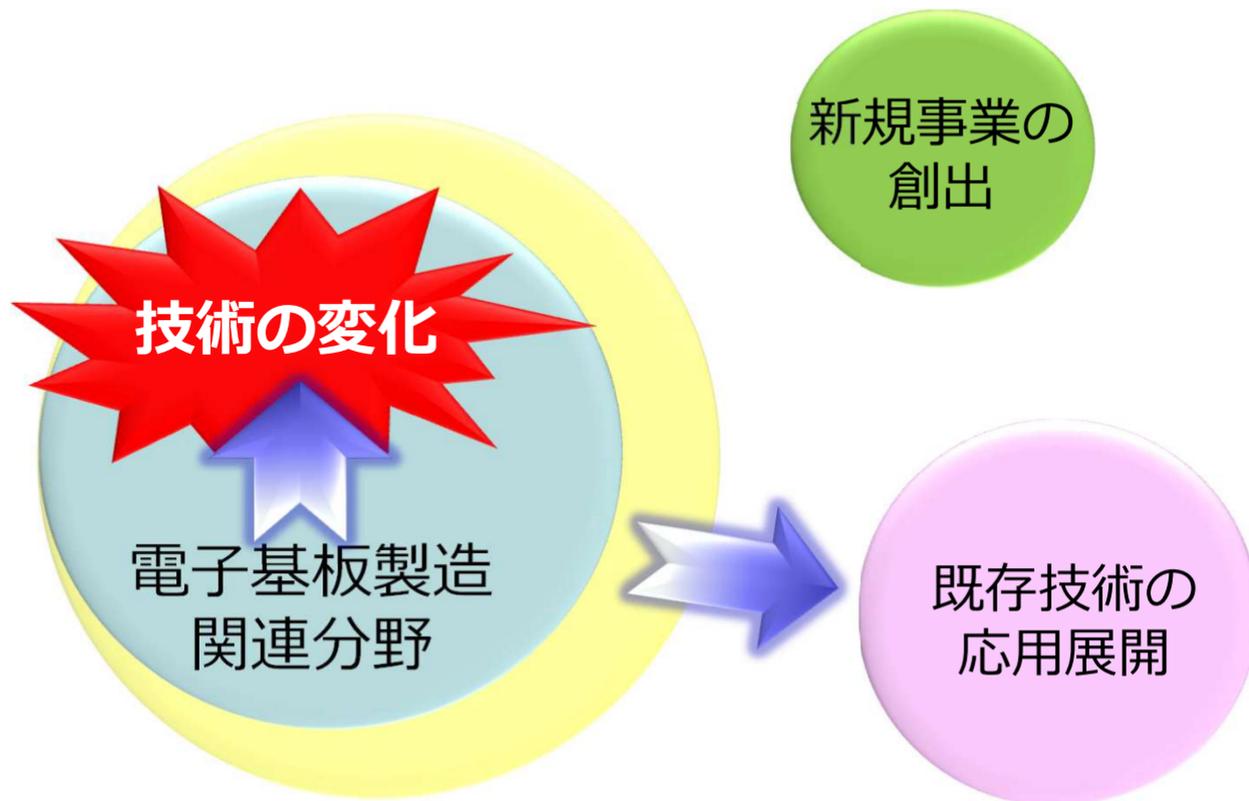
- ・適用製品：粗化密着処理（CZ）×化学密着処理（AP）
- ・技術動向：超高密度化（低L/S）
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

既存領域（PKG基板）

- ・適用製品：粗化密着処理（CZ）、化学密着処理（AP）
- ・技術動向：高密度化（低L/S）
低消費電力のニーズによる粗化量低減
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

新領域（高周波基板）

- ・適用製品：化学密着処理（AP）
- ・技術動向：信号低損失のニーズによる粗化量低減
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター
半導体検査機

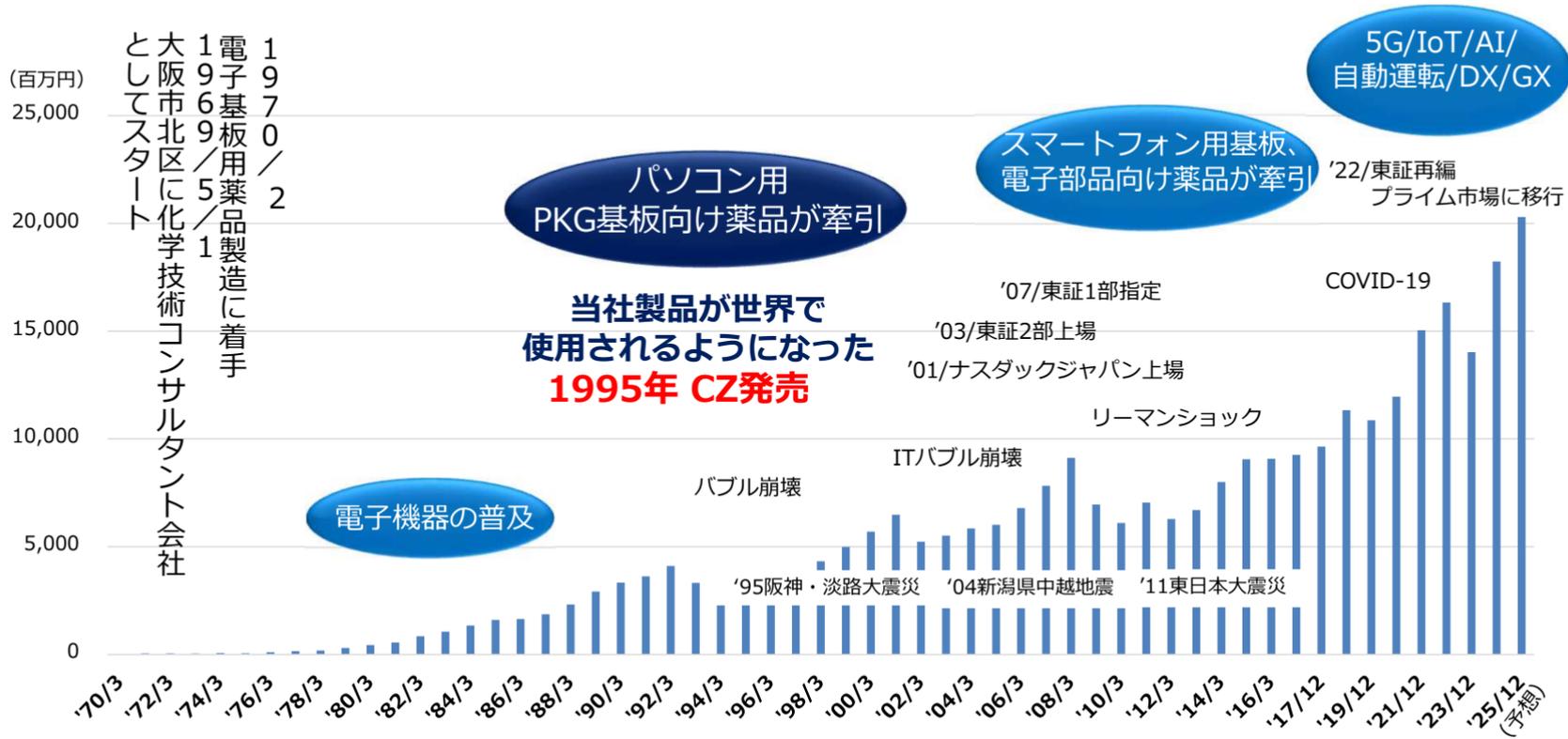


參考資料

(2024年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	182億34百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結480名、単体277名

創業からの売上推移





研究所から
工場へ

テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

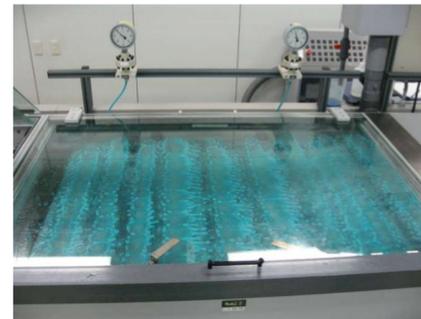
≪乾燥処理≫



≪水洗処理≫



≪薬液処理≫



基板受取



基板投入

界面価値創造

- 表面を粗化し、
機械的に密着性を向上

CZ、V-Bond



- 配線を形成する

EXE



- 選択エッチング

SF



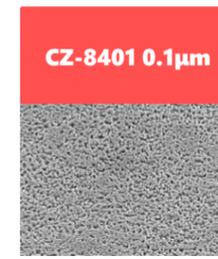
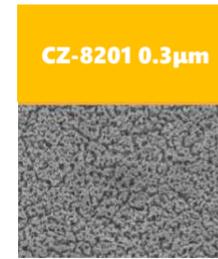
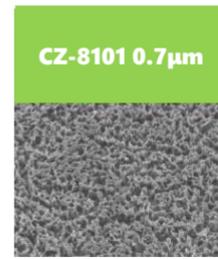
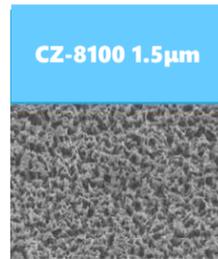
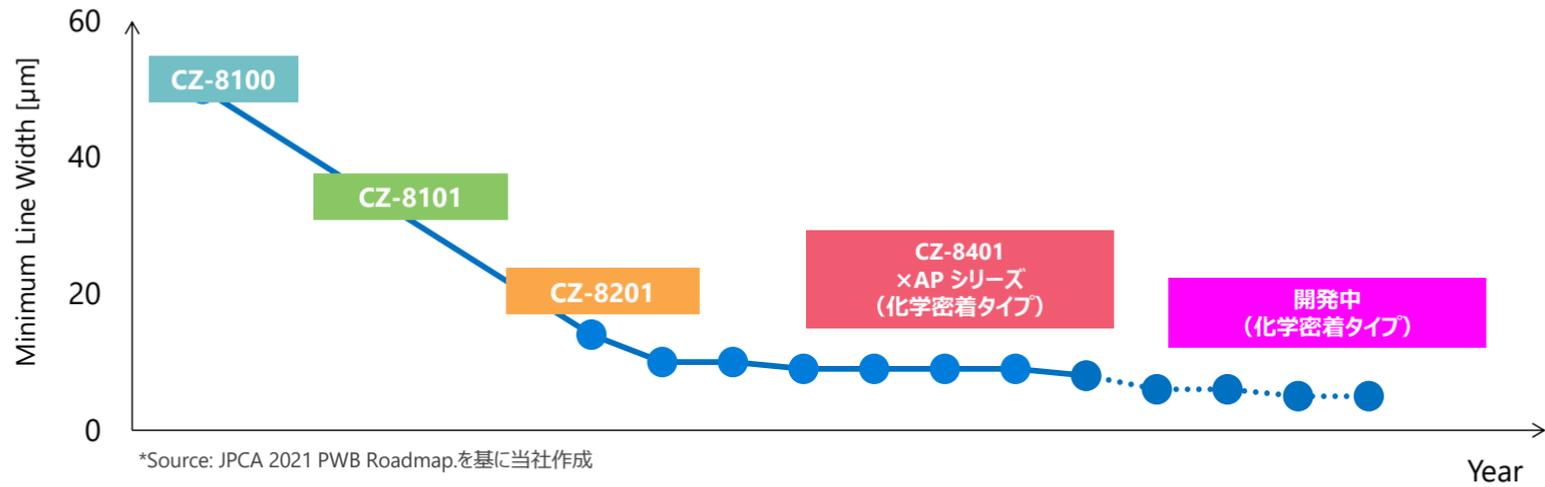
- 表面を処理し、
化学的に密着性を向上

AP

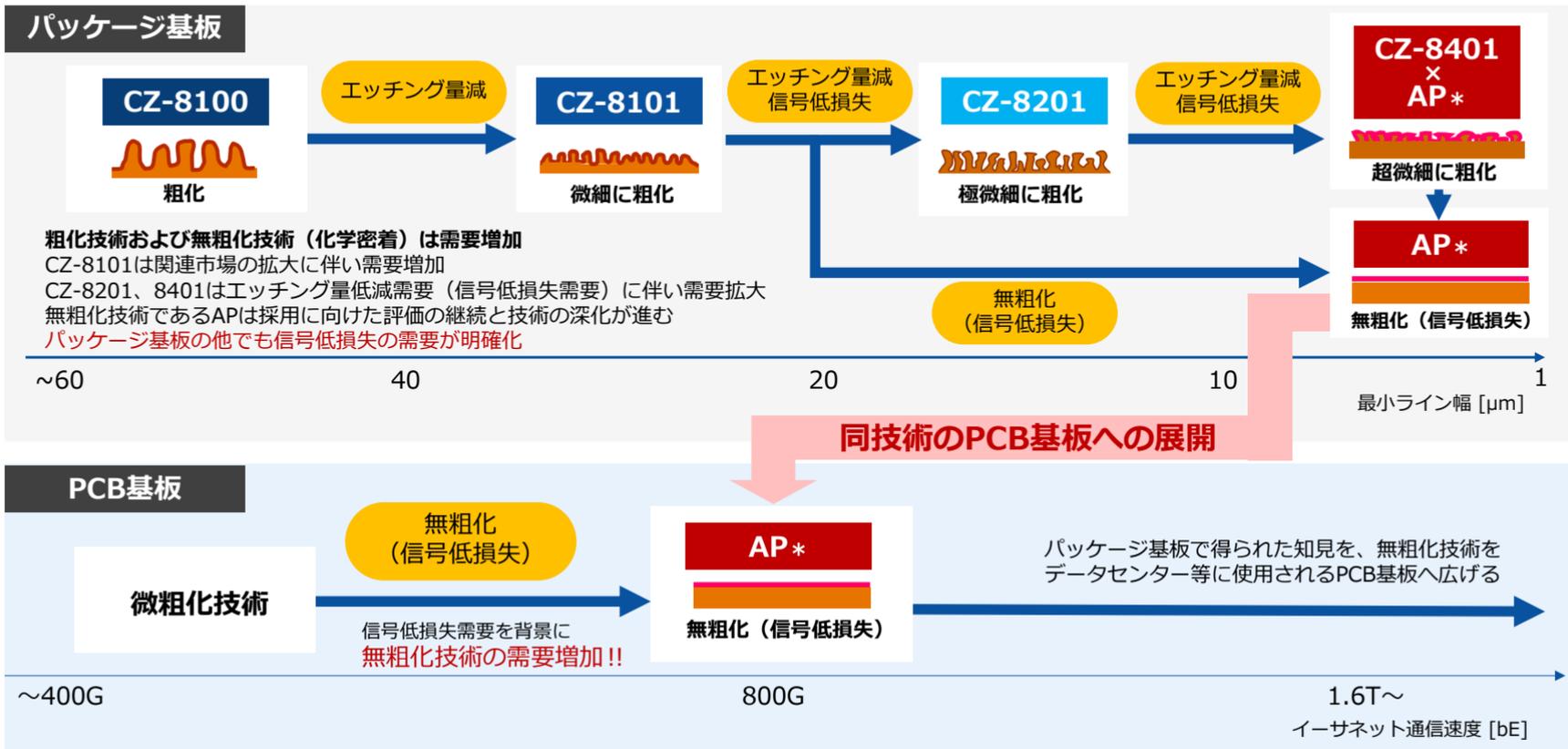


主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、高密度PCBにも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・データセンター等のインフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、PKG基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤として使用される。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

CZシリーズのロードマップ

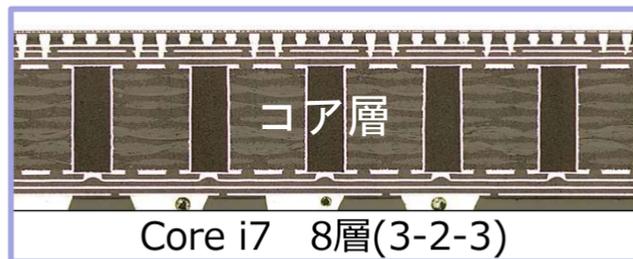
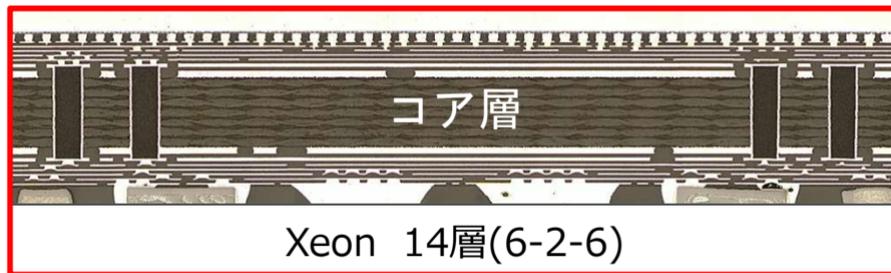


銅表面密着技術の変遷



* AP : Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

半導体パッケージ (PKG) 基板の断面



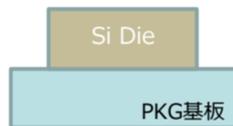
	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm ²	14
Core i7	14.44 cm ²	8
Ryzen	16.00 cm ²	12

*当社で入手、分解しました

半導体パッケージ (PKG) 基板の進化

通常のPKG基板

一つのPKGに一つの半導体



先端PKG基板

Chiplet、2.X/3D

PKGを大きくし複数の半導体を搭載

- PKGの高密度化
- PKGのサイズ大型化
- PKGの高多層化

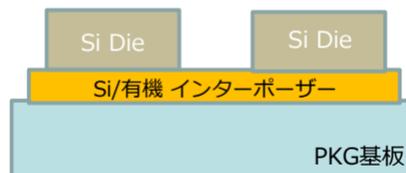
EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



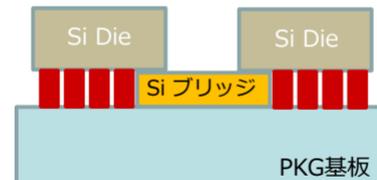
CoWoS

(Chip on Wafer on Substrate)



EFB

(Elevated Fanout Bridge)



■ 銅ピラー

メックグループ生産能力

国内拠点



尼崎工場（少量多品種）
900 t/月



長岡工場（量産工場）
2,750 t/月

新拠点



北九州工場（仮称）イメージ
最大生産能力 2,500 t/月（予定）
2026年12月稼働（予定）

海外拠点



メック台湾
1,200 t/月



メック蘇州
1,350 t/月



メック珠海
1,000 t/月



メックヨーロッパ
400 t/月



メックタイ
500 t/月

2024年12月現在

2024年12月末現在：8,100t/月（97,200 t/年）前期比12.5% 増強 * 除く北九州工場

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2025年11月11日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

